

Recommended Information 2023

Beschreibung

S-Bond® 200-1 ist ein Sn-Zn-Sb-basiertes aktives Lötmedium, welches eine Reihe von Metallen, Leichtmetallen und keramischen Materialien verbindet.

Schmelzbereich

- Solidus Temperatur: 199 °C (390,2 °F)
- Liquidus Temperatur: 229 °C (444,2 °F)
- Verbindungstemperatur: 250 – 280 °C (482 – 536 °F)

Physikalische Eigenschaften

- Dichte: 7.2 g/cm³ (0.264 lbs/in³)
- Thermischer Ausdehnungskoeffizient von R.T. 25 bis 150 °C (300 °F):
~19 x 10⁻⁶/ °C
- Elektrischer Widerstand (ρ): 1,6 μ-Ohm-m
- Wärmeleitfähigkeit:
 - Intrinsic: 48 W/mK

Mechanische Eigenschaften

- Zugfestigkeiten UTS 0,2% Y.S.
 - 25 °C 7.8 ksi (53 MPa) 5.6 ksi (38 MPa)
 - 75 °C 6.2 ksi (42 MPa) 4.7 ksi (32 MPa)
 - 175 °C 3.9 ksi (26 MPa) 3.4 ksi (23 MPa)
 - 190 °C 3.9 ksi (26 MPa) 3.0 ksi (20 MPa)
- Verbindungsfestigkeit (R.T.):
 - Aluminium zu Aluminium 2,9 – 4,3 ksi (20 – 30 MPa)
 - Stahl zu Stahl 2,9 – 7,5 ksi (20 – 30 MPa)
 - Edelstahl (Typ 304) 2,6 – 3,6 ksi (15 – 20 MPa)
 - Kupfer zu Kupfer 2,9 – 5,8 ksi (20 – 30 MPa)
 - Aluminium zu Stahl 4,8 – 6,5 ksi (33 – 35 MPa)
 - Al:SiC zu Metall 4.4 – 6.0 ksi (30 – 38 MPa)
 - Glas zu Metall 3,5 – 5,1 ksi (24 – 30 MPa)

Gemeinsame Dichtungsfähigkeiten

- Keine Angaben

Korrosion

- Ein guter atmosphärischer Schutz
- Bei anderen Korrosionsdaten, Updates oder Sonderwünsche.... Rufen Sie uns bitte an.

EUROMAT GMBH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der o.g. Werte. Werte wurden im Labor ermittelt und können chargenmäßig abweichen. Es empfiehlt sich die eigene Überprüfung nach Warenerhalt.